

## 電路板製作資料清單

|                                                                      |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 請購連絡人: <u>吳昆達</u> 部門: <u>M000</u><br>電話: <u>03-5912129</u> 傳真: _____ | 日期: <u>115</u> 年 <u>9</u> 月 <u>16</u> 日 | 請購單編號: _____ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|

**製作規格:**

- 1.板號: INDICATOR-260916(Gerber)
- 2.層數: 2 Layer
- 3.電路板尺寸: 115 MM X 34 MM (單片尺寸----- 0片併板)
- 4.銅箔厚度: 0.5 盎司 / 平方呎 (外層:0.3~0.5 oz 內層: 0.5 oz) 依疊構計算為主
- 5.電路板厚度: 1.5MM ± 0.1 MM 疊構參考下圖
- 6.板材: ☒ FR-4 ☐ BT ☐ PI ☐ FR-4補強
- 7.表面處理: 噴錫 ☒ 鍍金 ☐ OSP(Entek) ☐ 鍍銀
- 8.數量: 50 PCS
- 9.預訂完成日期: 115 年    月    日.
- 10.表面防焊 琥珀 透明 ☒ 綠 ☐ 黑

**交付資料:**

☒ Gerber File, 檔名 : INDICATOR-260916(Gerber).zip

☒ Master Drawing主圖 ,參考 \_\_\_\_\_ 內之檔案

**製作完成後,請歸還所有資料**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>備註:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O/S TEST : <u>YES</u> , <input type="checkbox"/>單面 <input checked="" type="checkbox"/>雙面</li> <li>2.金手指: <u>NO</u></li> <li>3.鍍金厚度: <u>YES</u></li> <li>4.阻抗控制: <u>NO</u></li> <li>5.AOI 測試: <u>YES</u></li> <li>6. BGA Substrate 特殊製程: <u>NO</u></li> <li>7. V-VUT : <u>NO</u></li> <li>8. 併板: <u>NO</u></li> <li>9. 排連片加版邊: <u>YES</u></li> <li>10. 盲埋孔: <u>NO</u> , <input checked="" type="checkbox"/>1階 <input type="checkbox"/>2階</li> <li>11. 版邊電鍍 <u>NO</u></li> </ol> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

收件廠商: \_\_\_\_\_ 簽收人: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**( 請收件廠商簽收後傳回連絡人處! )**

1. 本表單以板號作為資料之識別。
2. 本所所提供之技術資料,屬於本所之智慧財產權,僅限貴公司承製本案使用,用畢後應歸還本所,貴公司非經本所之書面許可,不得任意複製、使用、轉移、作為其他用途或移轉給第三者。